

# MW-G

- ・ MW-G銅箔は環境に配慮した銅箔で、特にHi-Tg材やハロゲンフリー材に適しております。  
MW-G copper foil comply with environment regulation is especially suitable for Hi-Tg and Halogen Free prepregs.
- ・ 十分な接着強度/優れた耐熱性/良好なエッチング特性  
Good bonding strength./ Excellent heat resistance./ Good etchability.
- ・ 最薄の9  $\mu$  mを安定して生産対応が可能でお客様のご要求を満足いたします。  
Our plant has stable capacity for 9  $\mu$  m thin foil to fulfill customer requirements.

## 用途/Application

- ・HDIマイクロビア配線板  
/High Density Interconnect(HDI)
- ・パッケージ配線板(薄箔)  
/Semiconductor Package(thin copper foil)

## 構成/Composition



## 生産拠点/Production Site

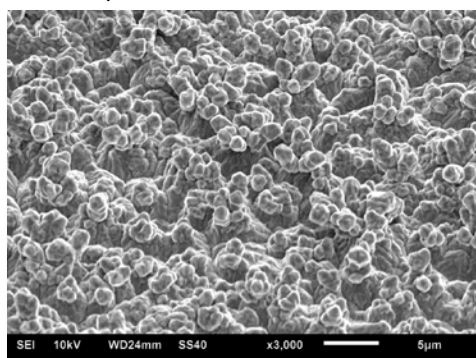
- ・台湾 / Taiwan
- ・マレーシア / Malaysia

## 代表的特性値/Representative data

|      | $\mu$ m | Rz<br>( $\mu$ m) | Tensile<br>Strength<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | Elongation<br>(%) | Peel Strength<br>(kg/cm) |
|------|---------|------------------|---|-------------------|--------------------------|
| MW-G | 9       | 3.8              | 370   | 4                 | 0.9                      |
|      | 12      | 4.2              | 370   | 6                 | 1.2                      |

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。  
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side

